

Title (en)

METHOD OF APPLYING A POLISHING CLOTH TO A POLISHING PLATE

Title (de)

VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN EINES POLIERTUCHS AN EINEN POLIERTELLER

Title (fr)

PROCÉDÉ D'APPLICATION D'UN PAPIER DE POLISSAGE SUR UN DISQUE DE POLISSAGE

Publication

EP 4212280 A1 20230719 (DE)

Application

EP 22151116 A 20220112

Priority

EP 22151116 A 20220112

Abstract (de)

Verfahren zum Anbringen eines Poliertuches an einen Polierteller in einer Poliermaschine zum Polieren von Halbleiterscheiben umfassend das Benetzen des Poliertellers mit einer Flüssigkeit, das in Kontaktbringen des Poliertuches mit dem Polierteller, wobei sich Teile der Flüssigkeit zwischen Polierteller und Poliertuch befinden; das lokale Andrücken des Poliertuches an den Polierteller, so dass die Flüssigkeit zwischen Polierteller und Poliertuch zum Rand des Poliertuches transportiert wird.

IPC 8 full level

B24B 37/20 (2012.01)

CPC (source: EP)

B24B 37/20 (2013.01)

Citation (applicant)

- US 5916016 A 19990629 - BOTHRA SUBHAS [US]
- EP 0208315 B1 19900926
- EP 1775068 A1 20070418 - FUJIKOSHI MACHINERY CORP [JP]
- US 2008248728 A1 20081009 - KANAYA KOICHI [JP], et al
- US 2001014570 A1 20010816 - WENSKI GUIDO [DE], et al
- US 2008102741 A1 20080501 - SHIH WEN-CHANG [TW], et al
- US 5510175 A 19960423 - SHIOZAWA KENICHIRO [JP]
- US 2014206261 A1 20140724 - ROETTGER KLAUS [DE], et al
- WO 2018086912 A1 20180517 - SILTRONIC AG [DE]
- DE 102019213657 A1 20210311 - SILTRONIC AG [DE]

Citation (search report)

- [XA] JP 2007313587 A 20071206 - SUMCO TECHXIV CORP
- [AD] EP 1775068 A1 20070418 - FUJIKOSHI MACHINERY CORP [JP]
- [AD] DE 102019213657 A1 20210311 - SILTRONIC AG [DE]
- [A] DE 10239774 A1 20031127 - WACKER SILTRONIC HALBLEITERMAT [DE]

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

Designated validation state (EPC)

KH MA MD TN

DOCDB simple family (publication)

EP 4212280 A1 20230719

DOCDB simple family (application)

EP 22151116 A 20220112